

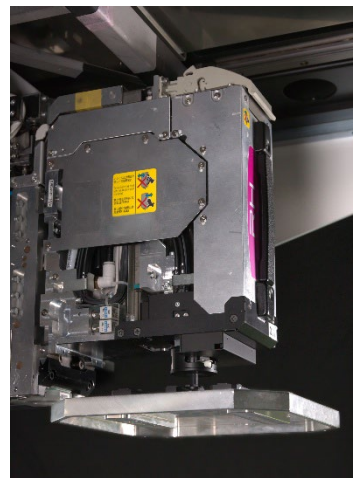
AI サーバー関連機器向けの大型重量部品実装技術を確立

～業界初、200×200mm・2.0kg の大型重量部品に対応～

株式会社 F U J I（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下「FUJI」）は、生成 AI の普及を背景に需要が高まる AI サーバー関連機器の生産に向けて、電子部品実装ロボット、クリームはんだ印刷機、自動化技術を組み合わせたソリューションの強化に取り組んでいます。このたび、当社の電子部品実装ロボット『NXTR』および『AIMEXR』の標準構成において、業界初^{※1}となる 200×200mm・2.0kg の大型重量部品に対応する実装技術を確立しました。



FUJI の電子部品実装ロボット
「NXTR S モデル」



大型重量部品

大型重量部品実装の様子

■ 開発の背景

生成 AI の普及を背景に、AI サーバーやデータセンター関連機器の高性能化が加速しています。これに伴い、GPU^{※2}、ASIC^{※3}、HBM^{※4}などを組み合わせた AI 半導体パッケージの大型化や、消費電力の大幅削減を可能にする光電融合といった新たな先端パッケージング技術（CPO^{※5}）の採用が進み、電子基板や実装部品にも大型化・重量化の対応が求められています。

FUJI は、“できない実装をゼロにする”「実装限界 ZERO」を目指し、実装工程における制約の一つひとつを解消する技術開発に取り組んでいます。今回、当社評価条件下において、200×200mm・2.0kg の大型重量部品を表面実装する技術を確立し、AI サーバー関連機器をはじめとする次世代エレクトロニクス生産における新たな実装ニーズへの対応領域を拡大しました。

■ 今後の展開

今後は、部品のさらなる大型化・重量化を見据え、対応領域をさらに拡大していきます。FUJI は「実装限界 ZERO」のコンセプトのもと、電子部品実装技術の開発を継続し、お客様の現場課題に応じた最適な提案を通じて、AI サーバー関連機器をはじめとする次世代エレクトロニクス生産の発展に貢献してまいります。

※1 当社調べ（2026 年 7 月 30 日時点）

※2 GPU (Graphics Processing Unit)：AI などの高度な演算処理を高速に行うプロセッサ。

※3 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)：特定用途向けに設計・最適化された半導体。

※4 HBM (High Bandwidth Memory)：高帯域幅を実現する積層型メモリ。

※5 CPO (Co-packaged Optics)：半導体と光通信部品を一体実装する先端パッケージング技術。

会社概要

会社名 : 株式会社 F U J I

代表者 : 代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地 : 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19

設 立 : 1959 年 4 月

事業内容 : 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売

資本金 : 5,878 百万円

FUJI 公式 HP : <https://www.fuji.co.jp/>

SMT 専用 HP : <https://smt.fuji.co.jp/>

本件に関するお問合せ先

株式会社 F U J I ロボットソリューション事業本部 マーケティング部 グローバルメディア課 白井

TEL : 0566-81-8263

お問い合わせフォーム : https://smt.fuji.co.jp/contact_other/